

半导体

把握新能源需求旺盛+新品发布升级迭代两大主线

本周行情概览：本周半导体行情跑赢部分主要指数。本周申万半导体行业指数上涨 0.42%，同期创业板指数下跌 0.84%，上证综指上涨 1.30%，深证综指下跌 0.14%，中小板指下跌 1.11%，万得全 A 上涨 1.31%。半导体行业指数跑赢部分主要指数。半导体各细分板块全部上涨。半导体细分板块中，IC 设计板块本周上涨 2.4%，半导体材料板块本周上涨 0.4%，分立器件板块本周上涨 0.5%，半导体设备板块本周上涨 4.0%，半导体制造板块本周上涨 1.1%，封测板块本周上涨 1.4%，其他板块本周上涨 1.0%。

IC 设计：新品发布与应用结构优化有望在周期波动中实现增长。存储芯片华邦电/旺宏/南亚科 6 月同比增速分别为 2.1%/8.4%/-31.5%。主控芯片联发科 6 月同比增长 6.9%；瑞昱同比增长 2%。MCU 盛群/新唐/松翰 6 月同比增速分别为 -13.3%/3.5%/-33.6%。高速传输芯片谱瑞/信骅/威锋电子 6 月同比增速分别为 42.6%/53.7%/-9.8%。模拟芯片方面需求分化，矽力杰 6 月实现营收 21.86 亿台币，同比增长 23.3%，致新 6 月实现营收 6.8 亿台币，同比下降 16%。显示驱动芯片方面，消费性电子产品需求疲软，联咏/敦泰/聚积 6 月实现营收 81.6/10.8/2.11 亿台币，同比增速分别为 -29.5%/-43.7%/-27.1%。射频芯片方面，相关厂商表现持续走低，稳懋/宏捷科/立积分别实现营收 15.9/2.04/2.76 亿台币，同比增速分别为 -22.6%/-48.6%/-48%。

功率器件：新能源需求持续向好，展望下半年 IGBT 价格或进一步提升。茂硅/杰力/富鼎/强茂 6 月分别实现营收 1.92/2.36/3.98/12 亿台币，同比增速分别为 14.9%/-5.6%/10.6%/-3.2%。碳化硅方面，5G 基建与车用工控等需求续强，汉磊与嘉晶 6 月分别实现营收 7.64 亿台币与 5.17 亿台币，同比增长 26.5%与 20.4%。

代工封测：产能维持高位，高速运算/车用需求推动增长。台积电/联电/力积电 6 月分别实现营收 1759/248/71 亿台币，同比增长 18.4%/43.2%/36.5%。封测方面，日月光/京元电/力成 6 月分别实现营收 580/32.3/80.9 亿台币，同比增长 33.9%/63.3%/14.6%。

建议关注：

1) **半导体设计：**纳芯微/宏微科技/东微半导/斯达半导/扬杰科技/新洁能/思特微/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/澜起科技/兆易创新/圣邦股份/思瑞浦/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/芯中科/海光信息

2) **IDM：** 闻泰科技/士兰微/时代电气/华润微/三安光电；

3) **晶圆代工：**中芯国际/华虹半导体；

4) **半导体设备材料：**北方华创/有研新材/海海清科/拓荆科技/华峰测控/沪硅产业/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/江化微/鼎龙股份；

风险提示：疫情继续恶化；上游供给不足；科研进度不及预期；需求不及预期

证券研究报告

2022 年 07 月 24 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

潘暕 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

程如莹 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

骆奕扬 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:22H1 国内设备龙头中标同比涨势乐观，H2 材料板块性机会显现》 2022-07-17
- 2 《半导体-行业研究周报:原材料涨价+国产替代加速，半导体材料量价齐升》 2022-07-10
- 3 《半导体-行业研究周报:政策助推国产化，半导体材料的板块性机会显现》 2022-07-05

内容目录

1. 每周谈：聚焦新能源应用，看好后市商用需求.....	3
1.1. 中国台湾半导体企业 6 月营收数据	3
1.2. IC 设计：新品发布与应用结构优化有望在周期波动中实现增长	4
1.3. 功率器件：新能源需求持续向好，展望下半年 IGBT 价格或进一步提升	8
1.4. 代工+封测：产能维持高位，高速运算/车用需求推动增长	8
2. 本周半导体行情回顾	10
3. 本周重点公司公告	11
4. 本周半导体重点新闻	12
5. 风险提示：	13

1. 每周谈：聚焦风光车储等新能源应用，看好后市商用需求

1.1. 中国台湾半导体企业 6 月营收数据

新能源及服务器相关需求仍较旺盛，6 月中国台湾半导体企业同比增速分化加剧。存储芯片华邦电/旺宏/南亚科 6 月分别实现营收 89/39.1/52.3 亿台币，同比增速分别为 2.1%/8.4%/-31.5%，同比增速因产品种类分化较为明显。主控芯片方面，新品新需求带动增长，联发科/瑞昱 6 月分别实现营收 510/96.4 亿台币，同比增速分别为 6.9%/2%。MCU 盛群/新唐/松翰 6 月分别实现营收 5.13/38.8/3.37 亿台币，同比增速分别为 -13.3%/3.5%/-33.6%，同比增速因需求应用分化较为明显。高速传输芯片客户订单需求稳健带动拉货延续，谱瑞/信骅/威锋电子 6 月分别实现营收 22/5.05/2.43 亿台币，同比增速分别为 42.6%/53.7%/-9.8%。显示驱动芯片方面，消费性电子产品需求疲软，联咏/敦泰/聚积 6 月实现营收 81.6/10.8/2.11 亿台币，同比增速分别为 -29.5%/-43.7%/-27.1%。模拟芯片方面需求分化，矽力杰 6 月实现营收 21.86 亿台币，同比增长 23.3%，致新 6 月实现营收 6.8 亿台币，同比下降 16%。射频芯片方面，相关厂商表现持续走低，稳懋/宏捷科/立积分别实现营收 15.9/2.04/2.76 亿台币，同比增速分别为 -22.6%/-48.6%/-48%。功率器件方面，光伏、车用电子、工控需求攀升。茂硅/杰力/富鼎/强茂 6 月分别实现营收 1.92/2.36/3.98/12 亿台币，同比增速分别为 14.9%/-5.6%/10.6%/-3.2%。碳化硅方面，5G 基建与车用工控等需求续强，汉磊与嘉晶 6 月分别实现营收 7.64 亿台币与 5.17 亿台币，同比增长 26.5%与 20.4%。晶圆代工方面，台积电/联电/力积电 6 月分别实现营收 1759/248/71 亿台币，同比增长 18.4%/43.2%/36.5%。封测方面，日月光/京元电/力成 6 月分别实现营收 580/32.3/80.9 亿台币，同比增长 33.9%/63.3%/14.6%。

表 1：中国台湾半导体企业月度数据情况

公司	22M06 营收 (亿台币)	22M05 营收 (亿台币)	22M06 营收月增 MoM %	22M06 营收年增 YoY %
华邦电	89	88.2	1%	2%
旺宏	39.1	35.5	10%	8%
南亚科	52.3	62	-16%	-32%
联发科	510	521	-2%	7%
瑞昱	96.4	105	-8%	2%
盛群	5.13	5.4	-5%	-13%
新唐	38.8	35.9	8%	4%
松翰	3.37	3.34	1%	-34%
谱瑞	22	21.9	0%	43%
信骅	5.05	4.66	9%	54%
威锋电子	2.43	3.01	-19%	-10%
联咏	81.6	110	-26%	-30%
敦泰	10.8	11.2	-4%	-44%
聚积	2.11	2.49	-15%	-27%
矽力杰	21.86	22.6	-3%	23%
致新	6.8	8.05	-16%	-16%
稳懋	15.9	18.3	-13%	-23%
宏捷科	2.04	1.97	3%	-49%
立积	2.76	3	-8%	-48%
茂硅	1.92	1.92	0%	15%
杰力	2.36	2.6	-9%	-6%
富鼎	3.98	4.37	-9%	11%
强茂	12	11.6	4%	-3%

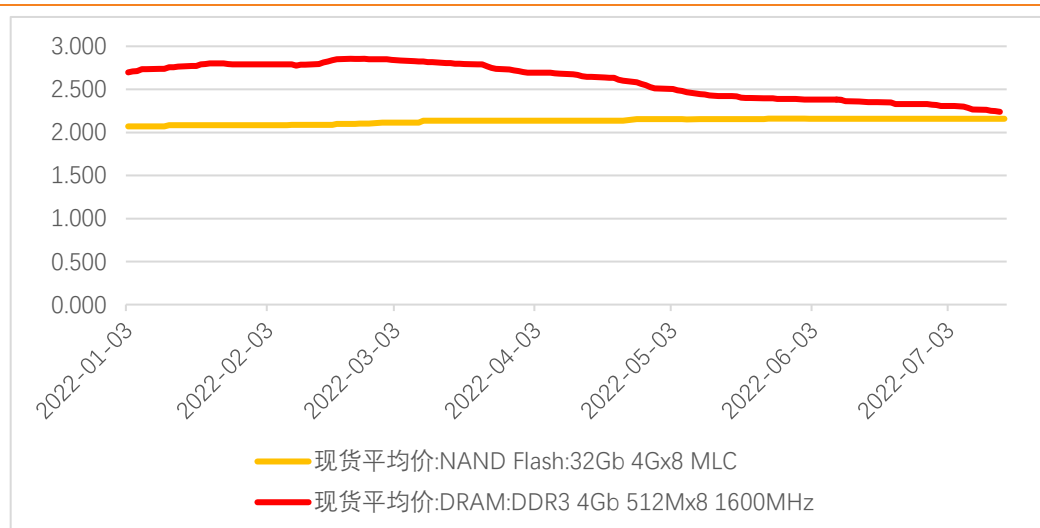
汉磊	7.64	7.51	2%	27%
嘉晶	5.17	5.11	1%	20%
台积电	1,759	1,857	-5%	18%
联电	248	244	2%	43%
力积电	71	74	-4%	37%
日月光	580	538	8%	34%
京元电	32.3	33.1	-3%	63%
力成	80.9	78.4	3%	15%

资料来源：Goodinfo，天风证券研究所

1.2. IC 设计：新品升级迭代和应用结构优化有望在周期波动中实现增长

存储芯片：周期波动延续，结构优化有望抵御消费需求疲软带来的影响。2022 年 6 月，中国台湾存储芯片厂商业绩同比增速分化，其中主营业务为 NOR/NAND Flash 的华邦电以及旺宏分别实现业绩 89 台币，39.1 亿台币，同比增长 2.1%与 8.4%；而主营业务为 DRAM 的南亚科实现营收 52.3 亿台币，同比下跌 31.5%。**1）NOR Flash 方面：**受消费性电子产品需求下滑影响，下半年低容量 NOR Flash 价格或将走跌，但随着车用、5G 等应用市场成长，高容量 NOR Flash 需求有望持续增长。旺宏持续聚焦高容量产品，今年第一季营收占比已达到 52%，且公司 80% 以上 NOR Flash 都在非 PC 或消费性电子产品领域，在分化行情下有望继续提升业绩。华邦电过去大多以中低容量 NOR Flash 布局为主，不过，随着高容量需求持续旺盛，去年来也逐步提升高容量产品比重，随着产品组合调整，毛利率也将持续改善。**2）NAND Flash 方面：**据 TrendForce 集邦咨询研究，随着铠侠(Kioxia)及西部数据(WDC.US)产出逐月提升，产能明显足以满足需求位元的增加，但消费性电子疫后需求降温导致订单递减，加上智能手机品牌在疫情及高通胀影响下，去库存或持续放缓，或导致第三季 NAND Flash 价格下跌 0~5%。**3）DRAM 方面：**因受外部宏观环境影响，DRAM 产业下半年挑战会较大；根据集邦数据，在下半年旺季需求展望不明的状态下，部分 DRAM 供应商已开始有降价意向，此情况将使第三季 DRAM 价格跌幅或扩大近 10%。同时，受益 1z / 1α 奈米先进制程持续转换，第三季供给有望季度环比增长，标准型 PC DRAM 第三季价格或跌幅修正为 5~10%。

图 1：DRAM/NAND 现货平均价走势（美元）



资料来源：DRAMexchange，wind，天风证券研究所

表 2：2022Q2-2022Q3 各类 NAND Flash 产品价格涨跌幅预测

NAND Flash 品类	2022Q2	2022Q3
eMMC	上涨 3-8%	下跌 3-8%
UFS		
Enterprise SSD	上涨 5-10%	趋稳

Client SSD	上涨 3-8%	下跌 3-8%
Graphic	增长 0-5%	下跌 0-5%
3D NAND Wafers (TLC&QLC)	下跌 8-13%	下跌 5-10%
Total	下跌 0-5%	下跌 3-8%

资料来源: TrendForce 集邦公众号, 天风证券研究所

模拟芯片: 重点关注高壁垒产品与景气向上应用, 车用多线道 PMIC 展望下半年需求强劲。

2022 年 6 月, 电源管理芯片厂商矽力杰与致新分别实现营收 21.86 亿台币与 6.8 亿台币, 同比增速分别为 23.3%与-16%。消费性需求在第二季虽持续疲软, 但商用 PC、伺服器需求仍有望维持成长。根据 TrendForce 集邦咨询数据, 2022 上半年不同功能芯片需求出现分化, 而电源管理芯片(PMIC)在全球电子装置与电力系统的发展下, 总体需求仍相对良好, 不过也因广泛应用于消费电子、通讯、运算、工控、汽车等领域, 下半年供需情况逐渐出现分化, 以车用的开关稳压器(Switch Regulator)、多通道电源管理芯片(Multi Channel PMIC)等需求较为强劲。2022 上半年面板、家电、消费笔电市场对功能与构造相对简单的线性稳压器、开关稳压器需求降低, 预估订单或有下修 15~30%的情况; 工控以及汽车市场, 在迈向工业 5.0、汽车电动化的趋势下, 下半年产品订价有望持稳向上。

表 3: 2022 下半年电源管理芯片需求预测

应用领域/产品类别	消费电子	通讯	运算	工控	汽车
线性稳压器	需求减缓	需求减缓	需求减缓	需求减缓	需求持稳
开关稳压器	需求减缓	需求持稳	需求持稳	需求持稳	需求强劲
多线道电源管理芯片	需求减缓	需求持稳	需求持稳	需求持稳	需求强劲
其他	需求减缓	需求减缓	需求减缓	需求持稳	需求强劲

资料来源: TrendForce 集邦公众号, 天风证券研究所

主控芯片: 二季度受益新品推出及商用需求延续增长。主控芯片厂商中, 联发科与瑞昱 6 月分别实现营收 510 亿台币与 96.4 亿台币, 同比增加 6.9%与 2.0%。联发科第 2 季三大项目的营收表现皆将呈现季增, 主要受益旗舰及高阶新品放量。随着全球首发天玑 9000+的小米 12 Pro 天玑版上市发售, OPPO、vivo、小米、荣耀等国内一线手机厂商都已经推出搭载联发科天玑 9000 系列的旗舰手机。根据 CINNO Research 统计, 2022 年 5 月中国智能手机 SoC 终端出货量约为 1912 万颗, 其中联发科智能手机 SoC 出货量约为 840 万颗, 环比增加 15.1%。网络通信芯片方面, 瑞昱 6 月合并营收主要受到疫情封控、客户库存调整等因素影响, WiFi、音效晶片(Codec)等产品出货动能放缓, 但 2022 年上半年(1 月至 6 月)实现累计营收 602.56 亿元, 同比增长 22.5%; 对于下半年展望, 将受到全球通胀使消费性景气持续下滑, 使客户端在消费性产品拉货能见度大幅降低, 且针对消费性的库存调整或将持续到年底; 但商用市场需求较好仍有望保持一定拉货动能, 有望带动 WiFi 6、音效晶片、交换器(Switch)及以太网路等在商用市场的应用产品持续增长, 由于商用产品单价普遍较消费性产品高, 因此有机会抵消消费性需求波动带来的影响。

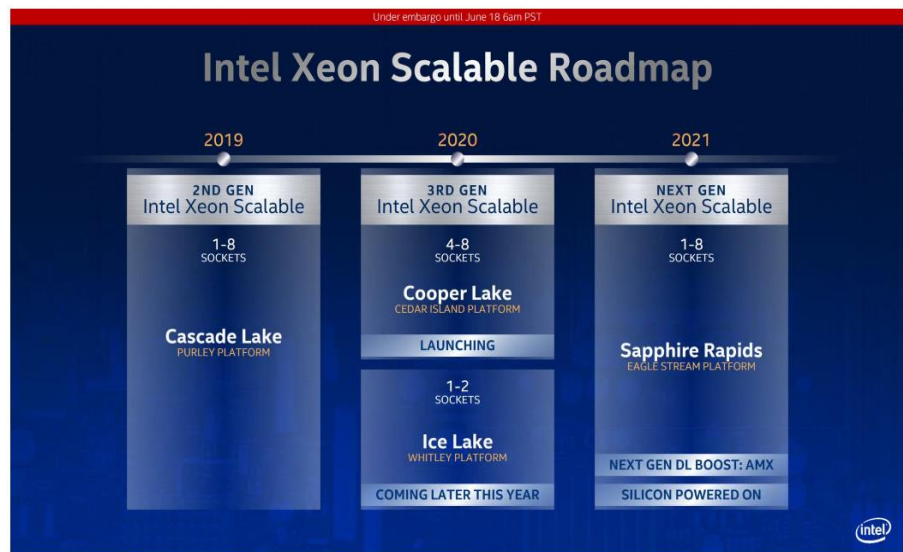
图 2: 2022 年 5 月中国智能手机 SoC 终端出货数据统计

No.	Brands	05'22			04'22	05'21
		Volume (M)	MoM	YoY	Volume (M)	Volume (M)
1	MediaTek	8.4	15.1%	-3.3%	7.3	8.7
2	Qualcomm	6.5	4.1%	-16.0%	6.2	7.7
3	Apple	3.0	0.2%	-10.8%	3.0	3.4
4	UNISOC	0.5	9.4%	-47.7%	0.4	0.9
5	Hisilicon	0.4	-5.5%	-81.5%	0.5	2.4

资料来源: CINNO Research, 天风证券研究所

高速传输芯片：英特尔 Sapphire Rapids 平台延迟或逐步受益数据中心替换需求。高速传输芯片厂商中，谱瑞、信骅 6 月分别实现营收 22 亿台币、5.05 亿台币，同比增长 0%、9%，业绩表现平稳，但威锋电子 6 月营收 2.43 亿台币，同比下降 19%。Sapphire Rapids 原定于 2021 年发货，随后英特尔推迟到 2022 年初，后来又将批量生产的时间推迟到 2022 年下半年。Sapphire Rapids 系列产品将使用 8 信道 DDR5，速度高达 4800 MHz，Sapphire Rapids 将采用新的微架构（有可能是 Golden Cove），旨在解决未来数据中心跨计算、网络和存储的动态和日益苛刻的工作负载问题。该处理器由一组丰富的平台增强功能提供支持，将提供集成高带宽内存（HBM），为内存带宽敏感的应用程序提供显著的性能改进，并推动采用 DDR5 内存和 PCIe 5.0 等改变行业的技术。另外，随着 AI 工作负载的重要性不断增加，英特尔正在 Sapphire Rapids 中集成高级矩阵扩展（AMX）。AMX 是英特尔下一代内置 DL Boost 的改进，提升了深度学习性能，具有一组矩阵乘法指令，可推进 DL 推理和训练。

图 3：英特尔“至强”系列芯片发展路线图



资料来源：Intel，国际电子商情，天风证券研究所

MCU：同比增速分化加剧，车用工控需求强劲有望带动增长。MCU 厂商盛群/新唐/松翰 6 月实现营收 5.13/38.8/3.37 亿台币，同比增长-13%/4%/-34%。消费需求上，盛群因国内市场需求放缓，消费性为主的家电产品受影响程度大，公司也应客户要求，根据个案与客户商讨价格调整，目前平均降幅约在 10%以内；随着大环境变化，包括客户、通路商等各自库存水位皆高，因此在终端需求降温下，公司或将价格调回疫情前水准，维系双方长期合作关系，也维持基本出货动能。2022 年下半年国际 IDM 大厂的 32 位元 MCU 产品单价虽然不见得能够再度涨价，但交期却也不见缩短迹象，甚至有些产品交期长达一年，供不应求的市场局面有望持续。从供应商层面来看，在消费类需求疲软的情况下，车用、商用的需求成为 MCU 厂商重点发力的方向。

表 4：2022Q2 海外龙头 MCU 厂商不同产品的货期与价格变化趋势

厂商	产品类别	货期（周）	货期趋势	价格趋势
Infineon + Cypress	8 位 MCU	45-52	延长	维稳
	32 位 MCU	45	延长	维稳
	汽车 MCU	32-45	延长	维稳
Infineon	汽车 MCU	紧缺	延长	维稳
Microchip	8 位 MCU	52+	延长	上涨
	32 位 MCU	52+	延长	上涨
	8 位 MCU	紧缺	延长	上涨
NXP	32 位 MCU	紧缺	延长	上涨
	汽车 MCU	紧缺	延长	上涨
Renesas	8 位 MCU	52	延长	上涨

	32 位 MCU	52	延长	维稳
	汽车 MCU	45	延长	维稳
	8 位 MCU	紧缺	延长	上涨
ST	32 位 MCU	紧缺	延长	上涨
	汽车 MCU	紧缺	延长	上涨

资料来源：富昌电子官网，天风证券研究所

图 4：新唐、NTCJ 产品结构示意图

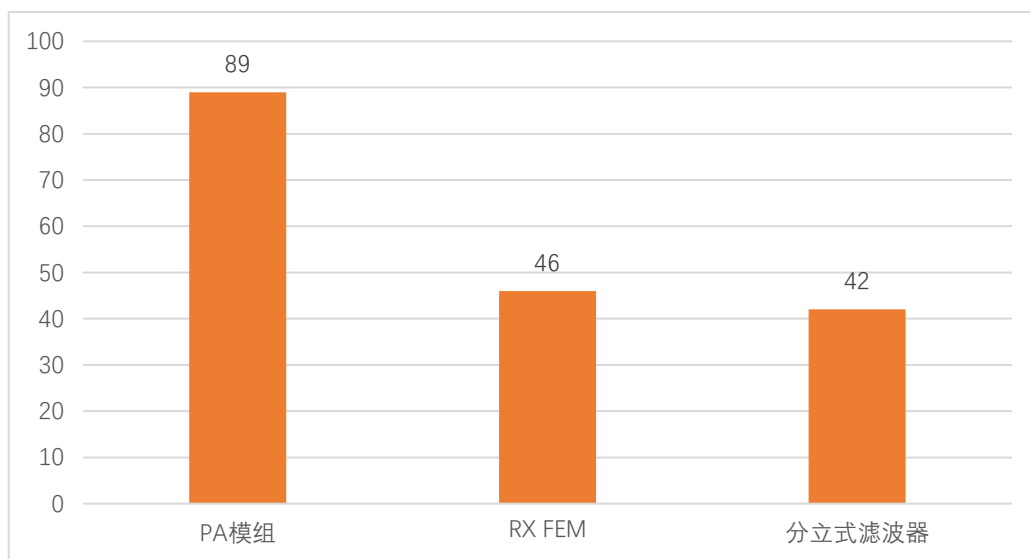
	Business				
	General Purpose	Smart Home	Cloud Security	Image Processing	Battery Management
Technology					
MCU / DSP	○○	○○	○○	○	○
Security	○○		○○	○	○
Analog Interface / Audio	○○	○○	○○	○	○
Low Power	○○	○○	○○	○	○
Sensing	○	○	○	○	

○ Nuvoton Taiwan ○ NTCJ

资料来源：新唐，并购情报网，天风证券研究所

射频芯片：WiFi 需求持续升温，手机需求有望回稳。6 月份砷化镓代工厂商稳懋与宏捷科 6 月分别实现营收 15.9 亿台币与 2.04 亿台币，同比分别减少 23%与 49%；射频前端厂商立积 6 月实现营收 2.76 亿台币，同比减少 48%。宏捷科指出，WiFi 方面自今年 1 月起开始增加，客户不仅对旧产品回补库存，新产品需求也增温，整体 WiFi 需求回温，目前看来将逐月增加，WiFi 5 与 WiFi 6 皆然，虽然现阶段以 WiFi 5 比例稍高，但 WiFi 6 逐渐成为主流，预期下半年 WiFi 6 需求将超越 WiFi 5。从供应端层面看，产品供应结构分化加剧，RFID 货期在 28-30 周左右，部分 WiFi 模组货期长达一年以上。射频前端包括功率放大器（PA）、滤波器（Filter）、开关（Switch）、低噪声放大器（LNA）、天线调谐器（Tuner）。从产品市场构成来看：PA 模组、RX FEM、分立式滤波器，构成射频三大主体。据 Yole 预计，到 2025 年对应的市场规模将达到 89、46、42 亿美元。

图 5：2025 年射频市场规模预测(单位：亿美元)



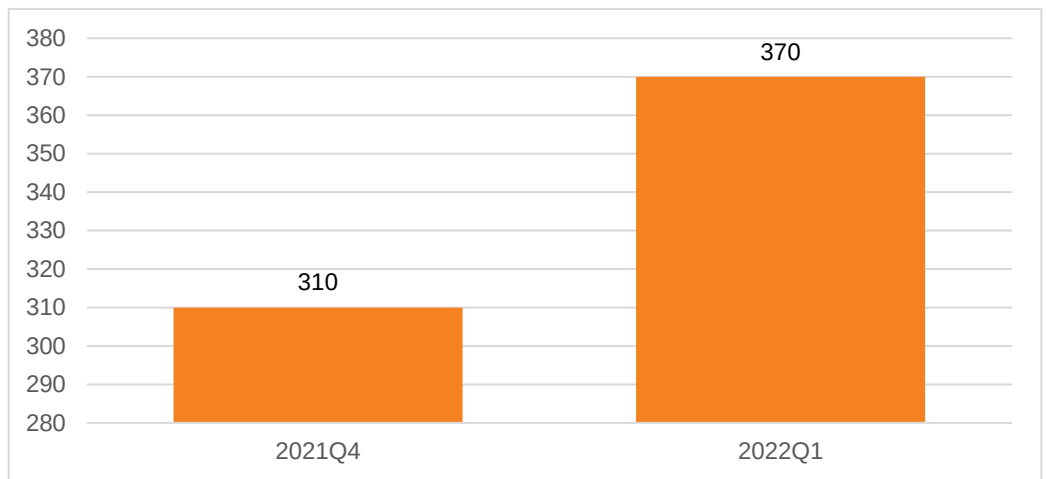
资料来源：Yole，国际电子商情，天风证券研究所

显示驱动芯片：受消费类需求影响，全年需求能见度低。显示驱动芯片厂商中，联咏、敦泰与聚积 6 月分别实现营收 81.6 亿台币、10.8 亿台币与 2.11 亿台币，同比下跌 30%、44% 与 27%。根据中国半导体显示研究机构 CINNO 数据，第二季度全球显示面板驱动芯片 DDIC 价格降幅约在 2%至 8%，第三季度价格降幅或将继续扩大至 4%至 15%。CINNO 预期在通胀的影响下，电视、笔记本电脑与商业显示市场需求持续疲软；其中，电视品牌大厂砍单，面板价格跌至历史低点，中大尺寸面板 DDIC 价格承压，导致第二季度 DDIC 价格下降约 2%至 8%，第三季度各类应用 DDIC 价格目前需求能见度较差，环比降幅预计将在 4%至 15%。

1.3. 功率器件：下半年 IGBT 价格或进一步提升，碳化硅蓄势待发

新能源需求旺盛供不应求或延续，IGBT 下半年或进一步涨价。功率器件厂商方面，茂硅/杰力/富鼎/强茂 6 月实现营收 1.92/2.36/3.98/12 亿台币。茂矽车用二极管及金氧半场效应晶体（MOSFET）需求延续，第三季前产能有望持续满载，至于中国太阳能逆变器需求大增导致绝缘闸双极电晶体（IGBT）缺货，预估下半年价格有望进一步提升，此外公司看好第三代半导体未来发展趋势，预计 2023、2024 年切入第三代半导体市场。根据英飞凌数据，2022 年 1-3 月公司积压的订单金额从去年四季度的 310 亿欧元增长了 19.4%至 370 亿欧元（约合人民币 2671 亿元），且 75%的订单在未来 12 个月内才能交货，积压订单显然远超出公司的交付能力，显示供不应求的情况或延续。

图 6：英飞凌积压的订单金额（亿欧元）环比增加 19.4%



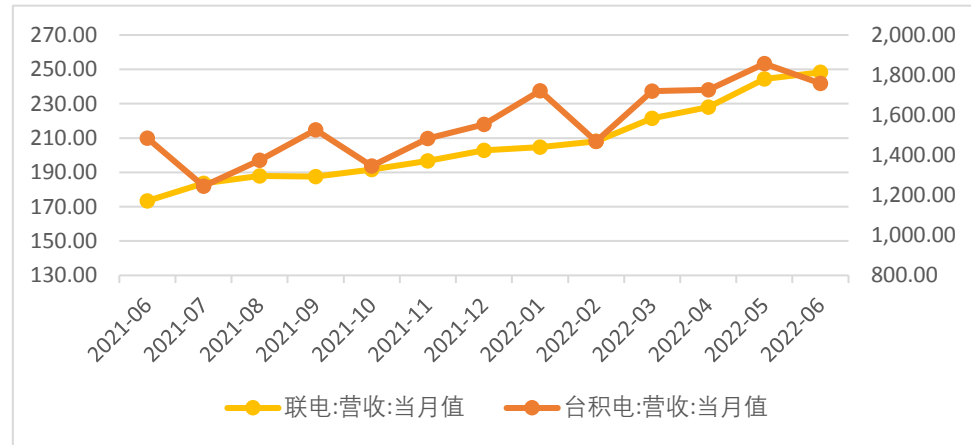
资料来源：英飞凌首席营销官 Helmut Gassel，国际太阳能光伏网，天风证券研究所

碳化硅：同比维持高增速，供不应求延续下半年或进一步涨价。碳化硅厂商方面，汉磊与嘉晶 6 月分别实现营收 7.64 亿台币与 5.17 亿台币，同比增长 26.5%与 20.4%，环比增长 1.8%与 1.2%。汉磊、嘉晶受惠 5G 基建与车用工控等需求续强，以及国际 IDM 大厂扩大功率半导体委外代工，带动今年营收走高，汉磊第二季营收 22.52 亿元，季增 6.9%、年增 29.2%，嘉晶第二季营收 15.33 亿元，季增 4.15%、年增 24.2%。展望后市，中国解封可带动电动车、太阳能、快充等需求增温，化合物半导体需求持续畅旺，汉磊及嘉晶可望受惠，其中，汉磊审慎乐观看待下半年，估可望优于上半年，部分价格上涨会在下半年显现，平均销售价格维看增。

1.4. 代工+封测：产能维持高位，高速运算/车用需求推动增长

晶圆代工：车用/云端服务器等需求强劲。晶圆代工方面，6 月台积电、联电与力积电分别实现营收 1759 亿台币、248 亿台币与 71 亿台币，同比增长 18.4%、43.2%、36.5%。台积电 22Q2 营收受到强劲的 HPC/IOT/汽车相关需求的支持，营收接近业绩展望上限（176-182 亿美元）；毛利率达到 59.1%，超过前一季度的业绩展望（56-58%）。联电 2022 年将投资 50 亿美元在新加坡新建一座晶圆厂，预计将于 2024 年底开始生产；并且，还将与日本电装合作，在联电子公司 USJC 的 12 英寸晶圆厂内合作生产车用功率半导体，以满足车用市场日益增长的需求。

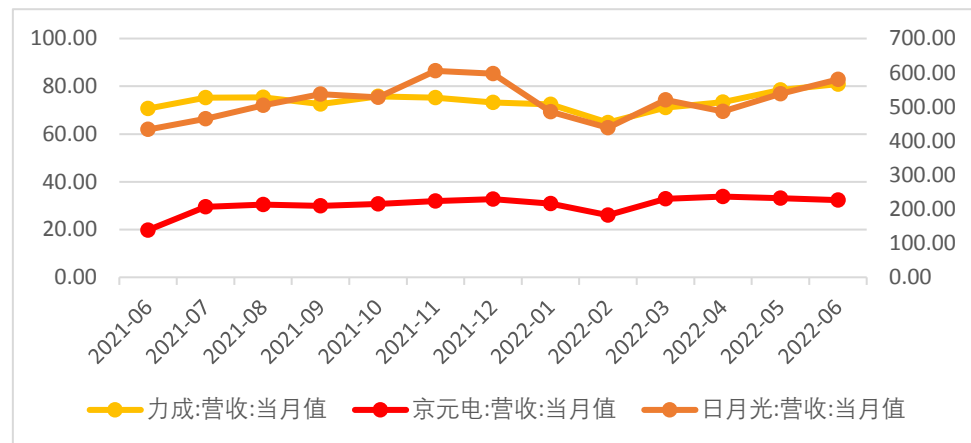
图 7：台积电与联电营收（亿台币）



资料来源：wind，天风证券研究所

封装测试：第二季度产能利用率维稳。封装测试厂商中，日月光、京元电与力成 6 月分别实现营收 580 亿台币、32.3 亿台币、80.9 亿台币。通膨因素导致消费性电子产品需求不如预期，客户对消费性产品订单调整幅度快且剧烈，会在这几个季度调整库存，连带影响日月光业绩。第二季度受到美国升息及疫情影响，使终端需求有杂音，虽然手机和消费性产品需求较差，但高运算、汽车等需求依旧强劲，日月光投控认为封测产能和供应吃紧将持续到 2023 年以后，HPC、汽车、5G、IOT 增长和不断扩大的矽含量导致强劲的终端需求和乐观的长期前景。

图 8：日月光、力成与京元电营收（亿台币）



资料来源：wind，天风证券研究所

2. 本周半导体行情回顾

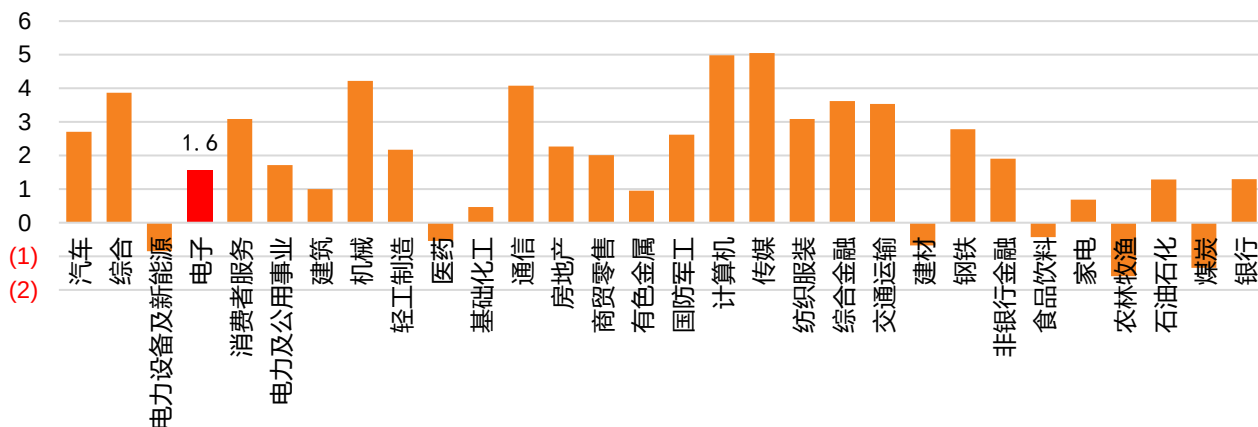
本周半导体行情跑赢部分主要指数。本周申万半导体行业指数上涨 0.42%，同期创业板指数下跌 0.84%，上证综指上涨 1.30%，深证综指下跌 0.14%，中小板指下跌 1.11%，万得全 A 上涨 1.31%。半导体行业指数跑赢部分主要指数。

表 6：本周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	-0.84	1.26
上证综合指数	1.30	-0.88
深证综合指数	-0.14	0.56
中小板指数	-1.11	1.53
万得全 A	1.31	-0.89
半导体（申万）	0.42	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

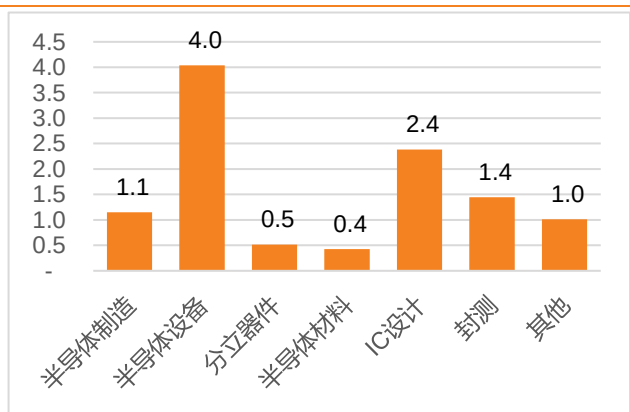
图 20：本周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

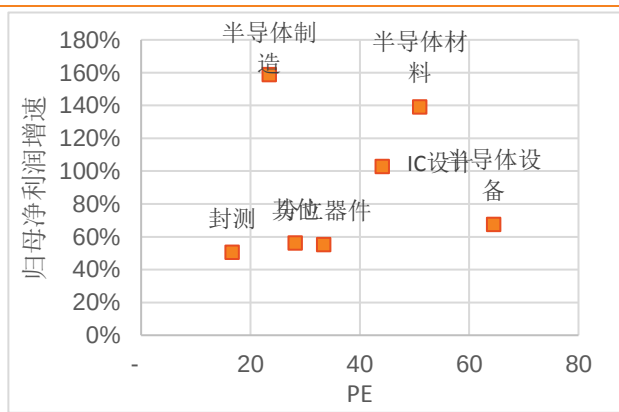
半导体各细分板块全部上涨。半导体细分板块中，IC 设计板块本周上涨 2.4%，半导体材料板块本周上涨 0.4%，分立器件板块本周上涨 0.5%，半导体设备板块本周上涨 4.0%，半导体制造板块本周上涨 1.1%，封测板块本周上涨 1.4%，其他板块本周上涨 1.0%。

图 16：本周子版块涨跌幅 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 17：半导体子版块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

本周半导体板块涨幅前 10 的个股为：天岳先进、华亚智能、长光华芯、恒玄科技、通富微电、长川科技、欧比特、清溢光电、台基股份、东微半导体。

本周半导体板块跌幅前 10 的个股为：新洁能、思特威、瑞芯微、复旦微电、国芯科技、士兰微、中科蓝讯、芯海科技、纳思达、澜起科技。

表 7：本周涨跌前 10 半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅%
天岳先进	25%	新洁能	-10%
华亚智能	17%	思特威-W	-7%
长光华芯	15%	瑞芯微	-6%
恒玄科技	12%	复旦微电	-6%
通富微电	11%	国芯科技	-6%
长川科技	11%	士兰微	-5%
欧比特	8%	中科蓝讯	-5%
清溢光电	8%	芯海科技	-4%
台基股份	7%	纳思达	-4%
东微半导	7%	澜起科技	-3.9838

资料来源：Wind，天风证券研究所

3. 本周重点公司公告

【晶晨股份 688099.SH】

公司于 2022 年 7 月 22 日公告《晶晨股份:2022 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》。公告显示，经财务部门初步测算，预计 2022 年半年度实现营业收入 310,000.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 109,824.67 万元左右，同比增长 54.86% 左右。预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,500.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 33,526.35 万元左右，同比增长 134.25% 左右。预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 56,200.00 万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 32,875.87 万元左右，同比增长 140.95% 左右。2022 年上半年，公司净利润相较于去年同期呈现较高增长，主要原因是公司产品线丰富多元，各业务产品齐头并进发展。公司积累了全球优质客户群且分散在全球主要经济区域。同时，受益于持续高强度研发投入，公司新一代 C 系列（自主研发的人工智能视觉系统芯片）、W 系列（Wi-Fi 6 2×2）新产品预期在下半年将陆续量产，将为公司带来新的客户群并注入新的增长动力。

【立昂威 605358.SH】

公司于 2022 年 7 月 22 日公告《立昂微:关于 2022 年半年度主要经营数据的公告》。公告显示，公司实现营业收入约 156,470 万元，同比增长 52% 左右；实现归属于上市公司股东的净利润约 50,260 万元，同比增长 140% 左右；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 45,500 万元，同比增长 147% 左右。主要是报告期内，受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速发展带动的下游需求持续增加，公司所处行业市场景气度持续高企，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，产能不断释放，主要产品产销量大幅提升。

【华海清科 688120.SH】

公司于 2022 年 7 月 21 日公告《华海清科:2022 年半年度业绩预增的自愿性披露公告》。公告显示，预计 2022 年半年度营业收入为 68,000 万元至 75,000 万元，较上年同期相比增加 38,638.98 万元至 45,638.98 万元，同比增长 131.60% 至 155.44%。公司预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,000 万元至 19,500 万元，较上年同期相比增加 9,945.79 万元至 12,445.79 万元，同比增长 140.99% 至 176.43%。公司预计 2022 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 14,000 万元至 16,500 万元，较上年同期相比增加 10,541.63 万元至 13,041.63 万元，同比增长 304.81% 至 377.10%。公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，提高了 CMP 设备生产和交付能力，积极拓展相关业务领域，配套服务及晶圆再生业务也得到了显著提升，销售收入及净利润均实现较大幅度同比增长。

【力合微 688589.SH】

公司于 2022 年 7 月 21 日公告《深圳市力合微电子股份有限公司 2022 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》。公告显示，公司预计 2022 年半年度实现营业收入 22,287.36 万元，与上年同期相比，将增长 8,387.94 万元，同比增长 60.35%。实现归属于母公司所有者的净利润为 3,000 万元至 3,300 万元，与上年同期相比，将增加 1,380.28 万元至 1,680.28 万元，同比增加 85.22%至 103.74%。实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 1,750 万元至 1,950 万元，与上年同期相比，将增加 772.91 万元至 972.91 万元。同比增加 79.10%至 99.57%。公司技术及芯片相关产品在各个市场方向上的应用开拓积极推进，对比上年同期，公司订单充足且稳步增长，同时产能得到有效保障，本期收入和利润有较大幅度增长。

【圣邦股份 300661.SZ】

公司于 2022 年 7 月 19 日公告《圣邦股份:关于公司控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》。公告显示，控股股东的一致行动人之一林林先生直接持有公司股份 24,750,280 股（占公司总股本比例 6.95%），预计减持数量不超过 6,187,570 股，即不超过公司总股本的 1.74%。

【国芯科技 688262.SH】

公司于 2022 年 7 月 19 日公告《国芯科技:关于自愿披露全资子公司被认定为 2022 年度天津市“专精特新”中小企业的公告》。公告显示，根据天津市工业和信息化局、财政局近期发布的《市工业和信息化局市财政局关于印发 2022 年度第一批“专精特新”中小企业认定名单的通知》，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津国芯科技有限公司（以下简称“天津国芯”）被认定为 2022 年度第一批天津市“专精特新”中小企业。天津国芯此次入选 2022 年度第一批天津市“专精特新”中小企业名单，是对其研发技术能力的肯定，充分体现了公司在细分市场领域的优势和品牌影响力，有利于进一步提升公司品牌知名度与市场竞争力，对公司整体业务发展产生积极影响。

【芯原股份 688521.SH】

公司于 2022 年 7 月 19 日公告《2022 年半年度业绩预告的自愿性披露公告》。公告显示，预计 2022 年 1-6 月实现营业收入 121,248.91 万元，同比增长 38.87%。公司预计 2022 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 1,482.24 万元，同比扭亏为盈，与上年同期（法定披露数据）相比，增加 6,046.74 万元。公司预计 2022 年 1-6 月实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为-1,343.03 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损收窄金额为 6,450.98 万元，较去年同期收窄 82.77%。

4. 本周半导体重点新闻

比亚迪宣布正式进入日本市场。半导体产业网获悉，7 月 21 日，比亚迪股份有限公司（以下简称比亚迪）日本分公司（BYD JAPAN 株式会社）在东京召开品牌发布会，宣布正式进入日本乘用车市场。与此同时，比亚迪公布并亮相了元 PLUS、海豚和海豹三款即将在日本乘用车市场发售的车型。比亚迪集团董事长兼总裁王传福发表视频致辞并表示：“作为全球最早研发新能源汽车的企业，比亚迪经过 27 年对绿色梦想的坚守，全面掌握了电池、电机、电控和车规级芯片等全产业链核心技术。今天，在日本消费者的支持和期待下，我们带着新能源乘用车来到日本。比亚迪和日本拥有共同的绿色梦想，这让我们与日本广大消费者没有距离。”元 PLUS 预计于 2023 年 1 月发售，海豚和海豹预计分别于 2023 年年中和下半年发售。（半导体产业网）

中科院上海微系统所团队实现基于 III-V 族量子点确定性量子光源和 CMOS 兼容碳化硅的混合集成光量子学芯片。近日，中国科学院上海微系统与信息技术研究所异质集成 XOI 团队实现基于 III-V 族量子点确定性量子光源和 CMOS 兼容碳化硅的混合集成光量子学芯片。通过设计双层垂直耦合器和 1×2 多模干涉仪 (Multimode interferometer, MMI)，研究团队

实现了混合量子光子芯片中确定性单光子的高效路由，以及对确定性单光子二阶关联函数的片上实验测量。相关研究成果于 2022 年 6 月 19 日以“Hybrid integration of deterministic quantum dots-based single-photon sources with CMOS-compatible silicon carbide photonics”为题在线发表在国际著名学术期刊 Laser & Photonics Reviews 上。该工作成功地在晶圆级 4H-SiC 光子芯片上实现 QD 确定性单光子源的混合集成，并实现了对确定性单光子二阶关联函数的片上实验测量，为实现同时具有确定性单光子源的 CMOS 兼容的快速可重构量子光子电路提供了一种新的解决方案和研究思路。（半导体产业网）

ASM 宣布收购意大利 SiC 外延设备制造商 LPE。半导体产业网获悉 7 月 18 日，ASM International N.V.（ASM）宣布达成一项协议，根据该协议，ASM 将收购位于意大利的碳化硅（SiC）和硅外延反应器制造商 LPE S.p.A 的所有流通股。LPE 成立于 1972 年，专注于设计、制造和销售用于电源应用的先进外延工具，是 SiC 外延领域公认的领导者，迄今已发布多项专利。LPE 在全球拥有庞大的 SiC 外延工具安装基础，专门用于制造满足快速增长的电动汽车市场的设备。ASM 总裁兼首席执行官 Benjamin Loh 表示：收购 LPE 为我们的差异化技术组合增添了另一项高增长业务，并通过利用我们的创新外延技术，建立我们在功率器件领域的重要客户群，进一步区分 LPE 的产品，为创造价值提供了有意义的细分市场机会，并利用我们的全球服务网络来满足客户需求。（半导体产业网）

比亚迪拟研发自动驾驶芯片。半导体产业网获悉，比亚迪将自主研发智能驾驶专用芯片，该项目由比亚迪半导体团队牵头，预计最快年底就可以流片，目前，比亚迪方面处于招聘 BSP 技术团队（给芯片上运行的操作系统提供一个标准的界面）的环节。对于从 BSP 入手研发芯片其实不罕见，业内人士透露可以在开发板上开发 BSP，可等芯片出来了再做联调，对于半导体行业，比亚迪可以说是强项，其半导体团队成立已逾 20 年，推出过 IGBT 芯片、车规级 MCU 芯片以及模拟 IC 芯片等产品。但虽说如此，对于自动驾驶芯片和数字座舱芯片此前并未曾涉及。（半导体产业网）

5. 风险提示：

疫情继续恶化、上游供给不足、科研进度不及预期、需求不及预期

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com